



---

2008年3月期  
**中間決算説明会**

2007年11月22日

**ワイエイシー株式会社**

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>

A solid blue horizontal bar spans the width of the page at the bottom.



# 次 第

---

1. ご挨拶と会社概要・・・・・・・・ 代表取締役社長  
百瀬 武文
2. 中間決算概要・・・・・・・・ 管理本部経理部長  
古橋 博
3. 第9次中期計画と基本戦略・・・・ 代表取締役社長  
・ (07年3月期～09年3月期)の概要 百瀬 武文
4. FEL新規事業計画について・・・・ 常務取締役  
佐藤 康男
5. 質疑応答



# 本日のキーメッセージ

- 2008年3月期の目標達成に向かって全力投球中
- 第9次中期計画(07年3月期~09年3期)基本戦略
  - 高収益企業への挑戦
  - マーケット深耕
  - ファブレス経営
  - カスタマー・サポートの充実
  - M&A、アライアンス
- 2008年度事業展開の準備をスタート
- FEL新事業の展望
  - FEL事業概要
  - 今後の見通し



# 1. 会社概要



## 基本情報

(2007年11月22日現在)

商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証2部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、福岡、大分、昭島、新潟 海外：台湾支店、上海事務所 工場：昭島、山梨、熊本
子会社	ワイエイシイ新潟精機株式会社 (新潟県妙高市) HYAC Corporation (米国) YAC Systems Singapore Pte Ltd (シンガポール)
資本金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決算	3月31日



## 2.当社の主力製品

### ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

### 液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置
- ・アニール装置

### 半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

### クリーニング関連

- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上機
- ・アパレル関連機



# 主力製品

## <ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーテクルの除去及び潤滑剤を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベア、AGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け)	(同上)但し、搬送物が300mm用ウエハカセットのため、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア



# 主力製品

## <液晶関連製品>

プラズマ・ドライ・エッチング装置	液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。 フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。
アニール装置	ガラス表面に塗布された半導体膜の結晶化と不純物の活性化を行う装置。



第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応  
基板サイズ

G2  
G4  
G4.5  
G5  
G5.5  
G6  
G7  
G7.5  
G8



## <半導体関連製品>

ロジック系IC用  
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。  
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)

## <クリーニング関連製品>

ボディープレス機	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。



シャツ用ボディープレス機  
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



---

## 2. 中間決算概要



## 中間期のハイライト(連結)

(単位:百万円)

科目	2006年3月期(実績)		2007年3月期(実績)		2008年3月期		対前年比 中間 増減率
	中間	通期	中間	通期	中間(実績)	通期(見込)	
売上高	7,637	18,050	10,451	22,423	12,790	25,000	22.4%
営業利益	843	2,495	1,708	3,676	1,596	3,750	▲6.6%
経常利益	864	2,401	1,694	3,583	1,586	3,650	▲6.4%
当期利益	590	1,504	1,095	2,103	1,038	2,200	▲5.2%
1株当たり当期利益	68.7	167.8	114.7	219.1	107.5	227.9	▲6.2%
営業利益率	11.1%	13.8%	16.3%	16.4%	12.4%	15.0%	-



## 中間期 事業別 売上金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年9月 中間	2006年9月 中間	2007年9月 中間	対前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	2,700	5,047	4,382	▲13.1%
液晶関連	3,563	3,910	6,995	78.9%
半導体関連	690	865	469	▲45.7%
クリーニング関連	683	627	943	50.3%
売上合計	7,637	10,451	12,790	22.3%



## 中間期 事業別 受注金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年9月 中間	2006年9月 中間	2007年9月 中間	対前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連			3,330	—
液晶関連	6,872	15,153	1,469	—
半導体関連			451	—
クリーニング関連	—	—	—	—
受注合計	6,872	15,153	5,251	▲65.3%

注:クリーニング関連事業については販売計画に基づいた見込生産を行っております。



## 中間期 事業別 受注残金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年9月 中間	2006年9月 中間	2007年9月 中間	対前年比 増減率(%)	2007年10月 現在		
メモリーディスク関連	}	}	1,743	—	1,800		
液晶関連			10,213	17,041	4,353	—	7,600
半導体関連			—	—	139	—	160
クリーニング関連	—	—	—	—	—		
受注残合計	10,213	17,041	6,236	▲63.4%	9,560		

注:受注残の来期分

(7,970)

(3,200)

注:クリーニング関連事業については販売計画に基づいた見込生産を行っております



## 損益計算書のレビュー

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2005年 9月中間期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期	対前年比 増減率(%)
売上高	18,711	18,050	22,423	7,637	10,451	12,790	22.4
売上原価	15,524	13,778	16,710	5,996	7,820	10,094	29.1
売上総利益	3,187	4,271	5,712	1,641	2,630	2,696	2.5
販管費	1,642	1,776	2,036	797	922	1,099	19.2
営業利益	1,545	2,495	3,676	843	1,708	1,596	▲ 6.6
営業外収益	112	42	73	51	40	41	2.5
営業外費用	149	136	166	30	54	51	▲ 5.6
経常利益	1,508	2,401	3,583	864	1,694	1,586	▲ 6.4
特別利益	-	6	8	1	5	5	0
特別損失	129	94	117	61	8	0	0
税引前当期純利益	1,378	2,313	3,474	804	1,691	1,591	▲ 5.9
税金費用	180	808	1,371	213	596	552	▲ 7.4
当期純利益	1,197	1,504	2,103	590	1,095	1,038	▲ 5.2

売上が増加しましたが、売上原価、販管費が増加したことにより増収減益になりました。





# 貸借対照表のレビュー

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2005年 9月中間期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期	前年同期末比 増減率(%)
流動資産	12,639	16,121	20,637	12,370	19,107	19,342	1.2
現金預金	2,860	4,726	5,359	2,147	4,764	4,468	▲6.2
売上債権	6,650	7,121	7,470	6,128	8,256	9,538	15.5
棚卸資産	2,850	3,914	7,203	3,825	5,566	5,130	▲7.8
その他	278	358	603	268	519	205	▲60.4
固定資産	3,103	2,744	2,969	2,907	3,071	3,440	12.0
有形固定資産	2,738	2,493	2,660	2,603	2,711	2,806	3.4
無形固定資産	17	13	109	15	73	104	41.1
投資その他の資産	347	236	199	288	286	529	84.8
資産合計	15,743	18,865	23,607	15,277	22,179	22,783	2.7
流動負債	9,050	8,468	12,465	7,823	11,046	9,729	▲11.9
仕入債務	6,745	5,855	9,199	5,462	8,347	6,854	▲17.8
短期借入金	1,569	1,041	1,363	1,577	1,127	1,642	45.7
その他	736	1,571	1,902	783	1,571	1,232	▲21.6
固定負債	2,080	4,189	1,097	2,247	1,985	2,152	8.4
社債・長期借入金	1,709	3,807	609	1,883	1,507	1,435	▲4.7
その他	371	381	487	364	477	717	50.1
負債合計	11,131	12,657	13,563	10,071	13,032	11,881	▲8.8
資本	4,612	6,207	10,044	5,206	9,147	10,901	19.1
負債及び資本合計	15,743	18,865	23,607	15,277	22,179	22,783	2.7

前年同期比で見ると、自己資本率が41.2%から47.8%に良化しております。



# キャッシュフロー計算書のレビュー

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2005年 9月中間期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期
税引前当期純利益	1,378	2,313	3,474	804	1,691	1,591
減価償却費	269	207	159	107	78	67
引当金の増減額	65	16	9	10	11	8
売上債権の増減額	▲2,581	▲181	127	627	▲858	▲2,634
棚卸資産の増減額	▲1,072	▲1,071	▲3,234	▲971	▲1,578	2,048
仕入債務の増減額	4,514	▲919	3,245	▲1,296	2,418	▲2,341
法人税等の支払額	▲25	▲404	▲1,502	▲258	▲923	▲662
その他	▲7	55	▲183	▲76	▲146	385
営業活動によるCF	2,541	15	2,095	▲1,054	693	▲1,538
投資活動によるCF	391	417	▲91	111	▲85	▲266
財務活動によるCF	▲2,020	1,652	▲1,400	195	▲595	958
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	59	6	33	3	▲25
現金及び現金同等物の増減	918	2,145	608	▲713	15	▲870
現金及び現金同等物の期末残高	2,581	4,726	5,335	1,868	4,742	4,465

**売上債権の増加により営業活動によるCFはマイナス**



# **3. 第9次中期計画と基本戦略の概要**

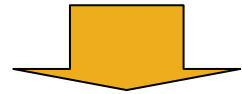
**(07年3月期～09年3月期)**



# 第9次中期計画の基本戦略

## I T産業の特徴

1. 高成長 2. 競争激化 3. 高スピード（技術革新） 4. 市場変動（大きい）



この事業環境における安定的収益確保

## ワイエイシイの基本戦略

1. 高収益企業への挑戦	<ul style="list-style-type: none"><li>・ オンリーワン技術の強化（差別化）</li><li>・ 依命システムの徹底</li><li>・ 低コスト経営の徹底</li><li>・ モチベーションの一層の高揚</li></ul>
2. マーケット深耕	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 顧客との強固な信頼関係構築による市場ニーズの先取りにより新製品バージョンUPによる差別化</li></ul>
3. ファブレス経営の徹底	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 営業、開発、技術、アフターサービスを中心とした経営体制</li><li>・ 市場変動による経営リスクの最小化</li></ul>
4. カスタマー・サポートの充実	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 顧客との強固な信頼関係構築による当社純正修理部品の利用推進と消耗品の拡大</li></ul>
5. M&A アライアンス	<ul style="list-style-type: none"><li>・ シェアUPと事業拡大</li></ul>



# 第9次中期計画の基本戦略

第9次中期計画（平成18年度～20年度）

平成17年8月31日

## 高収益企業 への挑戦

### 事業予算の達成

#### 事業部

- ・メモリーディスク
- ・半導体
- ・プラズマシステム
- ・クリーニング

#### グループ会社

- ・HYAC
- ・YSS
- ・YNS

### (1) 事業目標

- ・守りから攻めへの転換(営業利益40億超)
- ・高収益企業への挑戦(営業利益率15%超)
- ・企業価値の向上(時価総額500億円超)
- ・企業ステータスの向上(東証一部上場)

### (2) 高収益企業への事業戦略

- ・ソリューション型研究開発企業
- ・マーケット深耕
- ・ファブレス経営
- ・M&A, アライアンス
- ・グローバル経営
- ・やりがい経営

### (3) 高収益企業への仕組

#### オンリーワン技術

- ・製品開発と特許
- ・差別化と顧客密着
- ・プライスリーダー

#### 依命書システム

- ・営業員への粗利依命
- ・製作チームへの粗利依命
- ・デミングサイクルの実践

#### モチベーションの高揚

- ・部門経営ビジョンの明示
- ・徹底討論
- ・インセンティブ

#### 低コスト経営

- ・少数精鋭集団
- ・変化に即応
- ・事業効率の追求



## <ハードディスク市場>

- 動画アプリケーション等の増加による更なる大容量HDの必要性の拡大（書込み方式は垂直からデスクリート媒体へ）
- 携帯音楽プレーヤー、携帯電話、カーナビ、ビデオレコーダー、ビデオカメラ、スチルカメラ、その他各種デジタル家電製品へのHD搭載の拡大（用途拡大が継続し今後とも10%以上成長）
- フラッシュメモリとの競合は限定的で棲み分け(80GB以下フラッシュ)
- 市場の再編により下期が不透明感あり(WDとコマツグの合併等により)

## <液晶パネル市場>

- 薄型平面TV普及(液晶が主流)、40～50インチの大型化へ
- 2011年の地上波デジタル放送本格稼働までは積極的な設備投資が継続
- 昨年より有機ELパネルが再度動きはじめた
- 液晶パネル関連の設備投資再開(台湾)



## 事業環境

---

### <半導体市場>

- 前工程の旺盛な設備投資の拡大
- 後工程は下期以後来年にかけて設備増強が始まると見る。

### <クリーニング市場>

- 安定市場。消費回復と連動したクリーニング消費拡大の兆し
- 自動化設備投資に積極的な大手店と小規模店の二極化が進行
- 海外販売(米国、ヨーロッパ、中国)拡大



## 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
ハードディスク 関連事業	■ バニッシャーでは国内・ 外で約80%のシェア ■ マーケットリーダー	■ バニッシャー市場シェ アの拡大	■ バニッシャー世界シェア 100%を目指す（高スループ ット化、省スペース化）
		■ ワイピング市場シェア の拡大（垂直媒体に対 応）	■ ワイピングシェア100%を 目指す
		■ デスク、半導体・液晶 用コンベアの拡販	■ 海外も含めたコスト低減
		■ 消耗品の拡販	■ 消耗品の拡大 ■ 新テープの開発
液晶関連事業	■ プラズマ・ドライ・エッチン グでは市場シェア25% 程度を確保 （競合は1社のみ）	■ 市場シェアの拡大	■ 競合製品との差別化 オンリーワン技術の確立
		■ 粗利率の向上	■ 徹底したコストダウン ■ 協力会社との連携強化





# 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
半導体 関連事業	<ul style="list-style-type: none"><li>■市場シェア5%</li><li>■特定顧客との関係は強固</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■第2、第3の特定顧客の確保</li><li>■粗利率の向上</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■特定顧客確保に集中</li><li>■主要製品のバージョンアップ</li><li>■新製品の投入<ul style="list-style-type: none"><li>・16個同測ハンドラー</li><li>・簡易ハンドラー</li></ul></li></ul>
クリーニング 関連事業	<ul style="list-style-type: none"><li>■業界でのブランド力は強固</li><li>■包装機国内シェア約90%</li><li>■仕上機国内シェア約50%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■シェアアップ</li><li>■粗利率の向上</li><li>■海外売上の拡大</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■製品のシステム販売</li><li>■製販一体化によるコスト低減</li><li>■米国、中国、ヨーロッパへの拡大</li></ul>



# 2008年度通期計画(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (計画)		対前年 増減額 (計画)	対前年比 増減率(%) (計画)
				(上期)	(通期)		
売上高	18,711	18,050	22,423	11,500 (12,790)	25,000	2,577	11.5%
営業利益	1,545	2,495	3,676	1,500 (1,596)	3,750	74	2.0%
経常利益	1,508	2,401	3,583	1,450 (1,586)	3,650	67	1.8%
当期純利益	1,197	1,504	2,103	850 (1,038)	2,200	97	4.6%
1株当たり当期純利益 (円)	139.4	167.8	219.1	88.1 (107.5)	227.9	8.8	4.0%

注:( )は実績値



## 事業別売上金額(連結)

(単位:百万円)

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (計画)		対前年 増減額 (計画)	対前年比 増減率(%) (計画)
				(上期)	(通期)		
メモリーディスク関連	4,749	6,811	9,899	4,500 (4,382)	10,500	601	6.1%
液晶関連	10,919	8,525	9,400	5,500 (6,995)	10,600	1,200	12.8%
半導体関連	1,365	1,192	1,403	600 (469)	1,500	97	6.9%
クリーニング関連	1,678	1,522	1,721	900 (943)	2,400	679	39.5%
売上合計	18,711	18,050	22,423	11,500 (12,790)	25,000	2,577	11.5%

注:( )は実績値



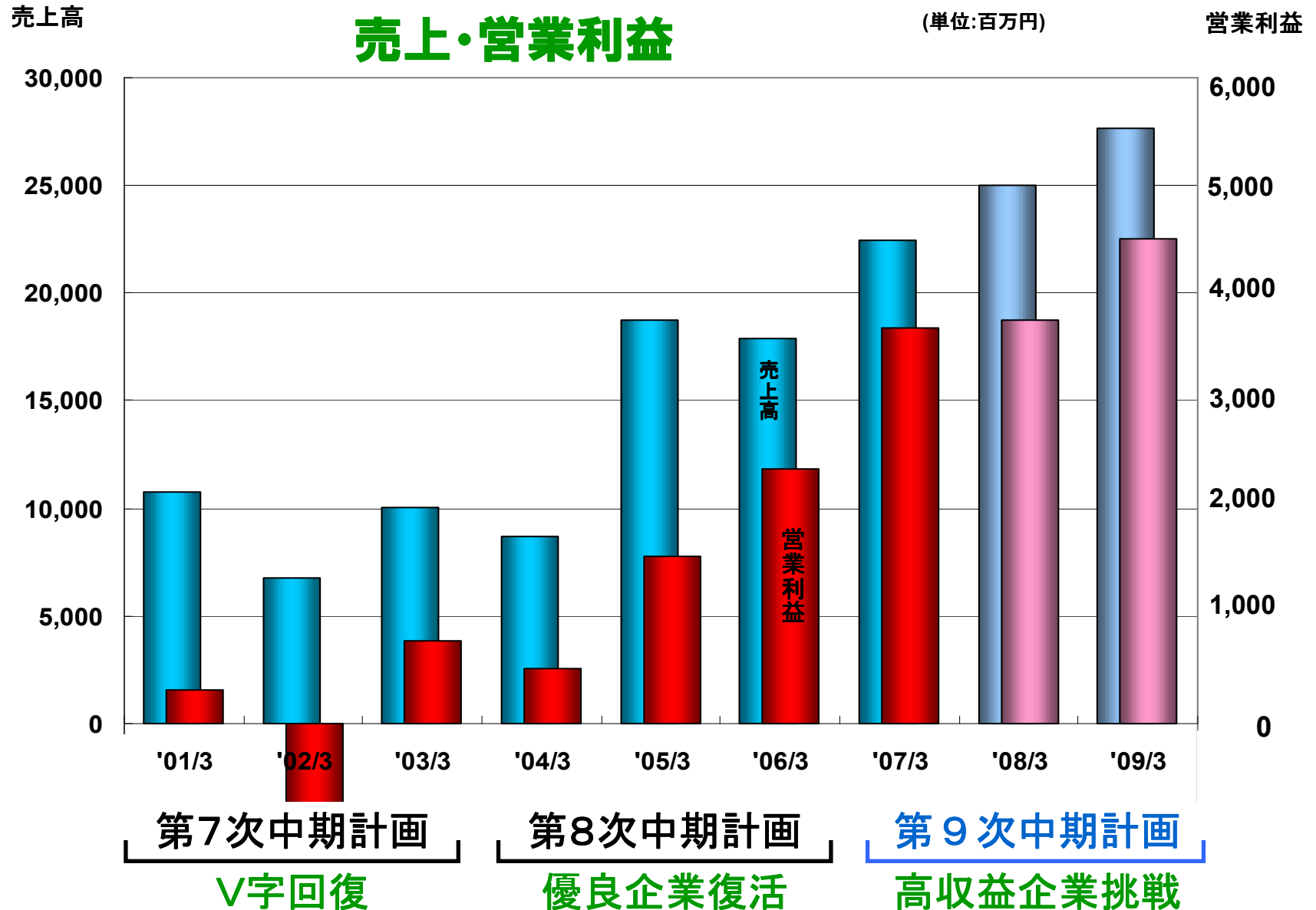
## 2008年度の事業準備（'07年度下期より実施）

---

1. 2008年度事業予算の策定
2. 予算達成に準備すべき課題
  - ・主力製品のシェア・アップ
  - ・開発製品（主力製品のバージョンアップ、新製品）
  - ・カスタマーサービスの拡大
3. 課題の消化スケジュール
4. 毎月のチェック



# 業績推移と第9次中期計画（連結）





業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。

ワイエイシイ株式会社



# FEL 新事業の展望

 **ワイエイシー株式会社**

**2007年11月22日**



## メッセージ

- 市場は温暖化と環境問題に対応を求めている
- 現在は新たな飛躍への準備段階
  - ・ サンプルの提供
  - ・ ランプ試作
  - ・ 品質安定
- 次のステップへ向けて量産戦略の策定





## 現在は新たな飛躍への準備段階

---

- サンプル膜の提供
  - ・ランプメーカー、特殊真空管メーカーへの試作を依頼
- ランプの試作
  - ・NDM自身でもランプ試作を行い基礎データの採取
- 品質安定(重点課題)
  - ・製膜、前後処理、寿命、輸送、保管方法の確立



## 業種別の動向

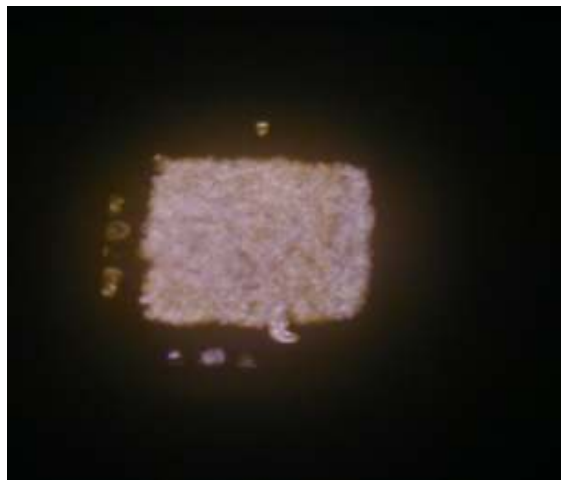
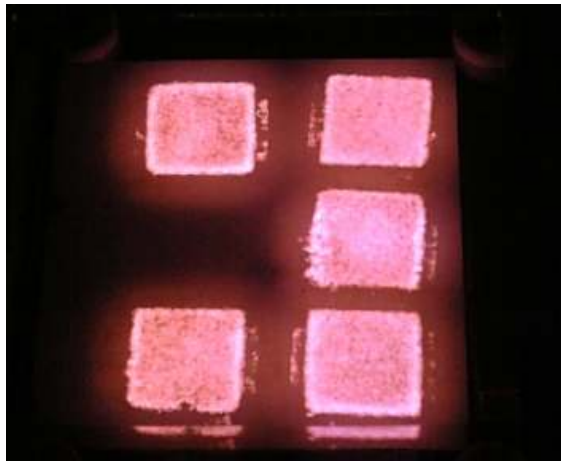
- ランプ
  - 農業用： 低発熱として工場農業用光源に期待  
太陽波長光源として期待  
(野菜の栽培・・・)
  - 照明： 水銀レス、省エネルギー、面発光  
(電気自動車用光源、表示灯、街灯・・・)
- 電子源
  - ： 面発光、省エネルギー  
(X線源・・・)



## エミッション(発光)テスト

## ND製膜装置

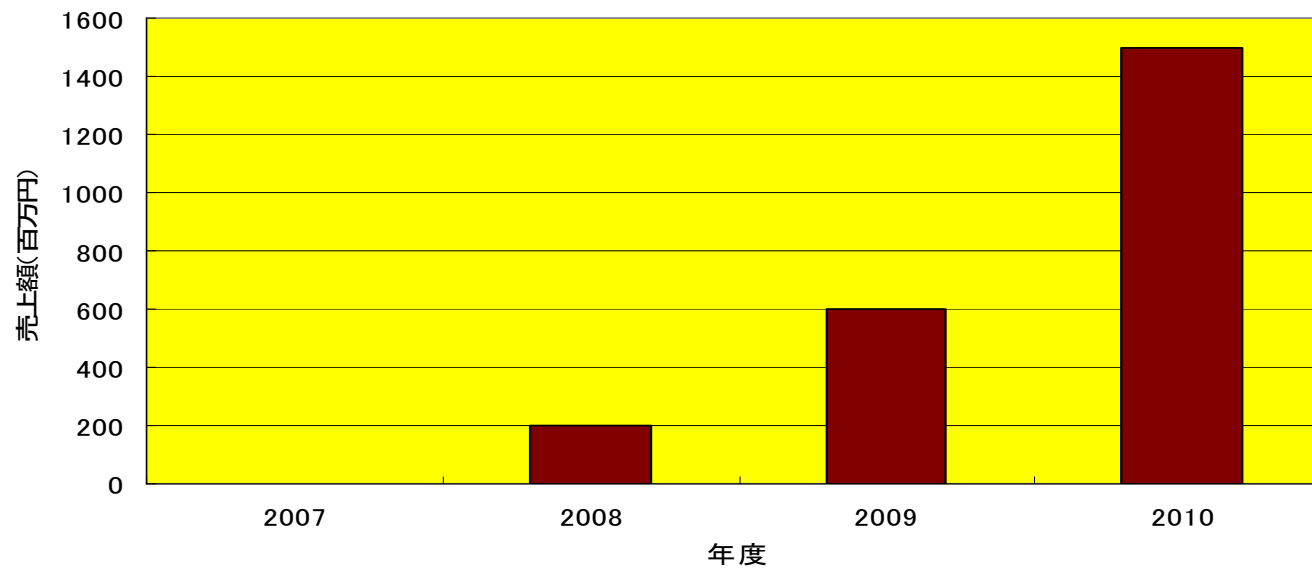
(高知NDマテリアル)





## 製膜計画(能力)・売上げ計画

売上計画





## 基本理念

電界放出特性の優れたナノダイヤモンド薄膜を製造し、ランプメーカーへ販売することにより、地球環境にやさしい照明を提供する。

- ・ 省エネルギー
- ・ 省資源
- ・ 脱有害物質(水銀レス等 RoSH対応)

▼現在のランプの問題点を解決する

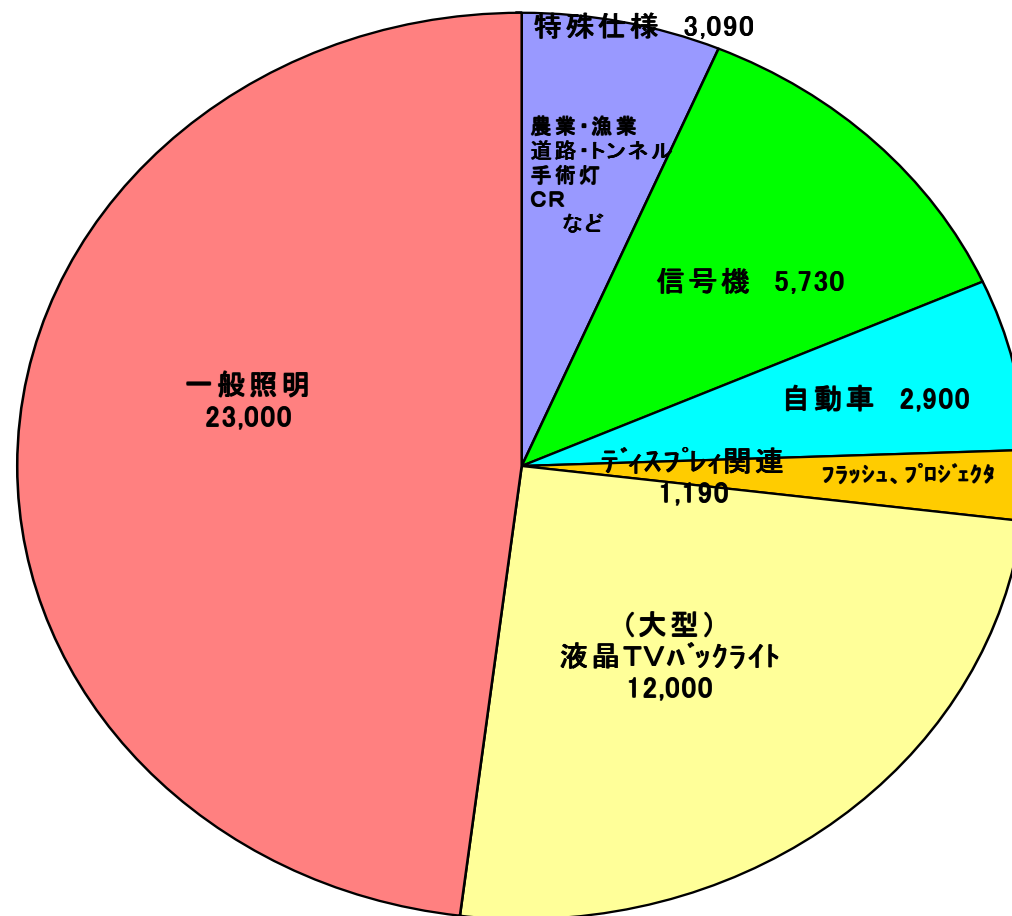
- ・ 蛍光灯(有害物質 :水銀、 低効率)
- ・ LED (高輝度時の低効率、 単波長、点光源)
- ・ 有機EL(短寿命or ムラ)



## ランプの市場規模 (NDM予測)

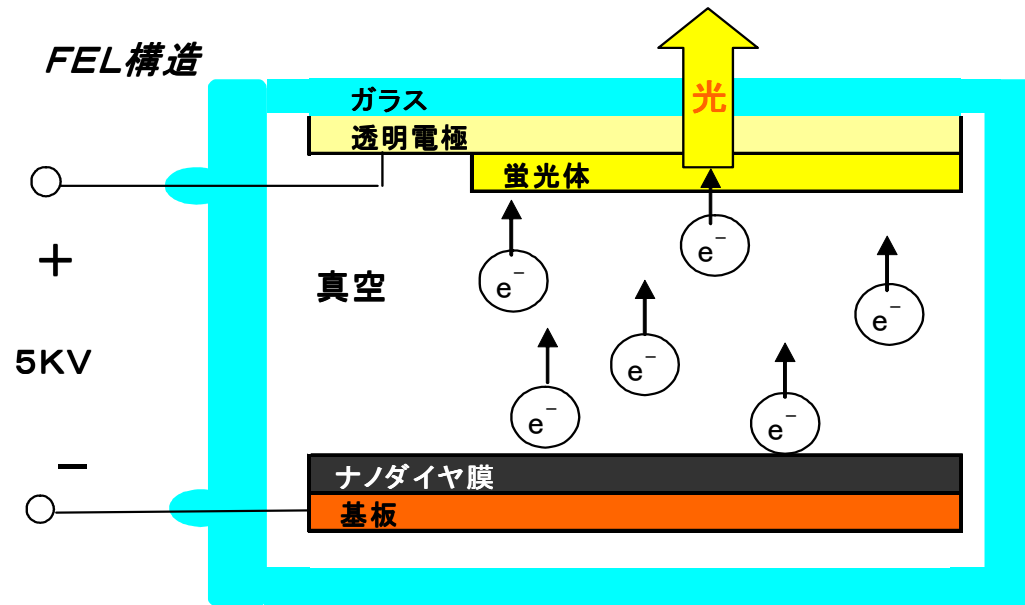
世界の照明市場(億円)  
2009年予測

総計 4.8兆円





## ナノダイヤモンド薄膜を利用したランプ(FEL)



ナノダイヤモンド薄膜から引き出した電子を加速して蛍光体に衝突させ、光に変える。

今までの電子放出(熱フィラメント)と異なり、冷陰極であり、又 平面から電子放出できる。



## FELの特徴（次世代ランプ比較）

	明るさ	消費電力	寿命	器具設計の自由度	コスト	実用化の例
FEL	◎	◎	◎	◎	◎	軟X線、特殊Tubeなど 光源としても製品化計画中
白色LED	○	◎	◎	◎	△	一般照明、信号機、自動車ランプなど
有機EL	△	△	○	◎	○	3年以内に照明として製品化計画中

